

利用課題番号 : F-13-WS-0071
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : 異種材料の接合
Program Title (English) : Bonding different materials
利用者名 (日本語) : 鈴木克彦
Username (English) : Katsuhiko SUZUKI
所属名 (日本語) : 株式会社ディスコ
Affiliation (English) : DISCO Corporation

1. 概要 (Summary) :

半導体製造での後工程で用いられるところに、異なる材料同士の接合を使ったプロセスが応用できると非常にプロセスが改善されることが予想される。

そこで我々は温度、接合雰囲気下、材料の表面状態、また材料の組成の違いによって接合強度がどのように変化するのについての相談を行った。相談の中でできた接合条件を基に今後、実験で確認していくことを予定した。接合強度の検証は破壊テストを行うとともに表面状態の解析も行う予定である。

材料の種類についてや、今回の手法は特許性を含むために、実験結果を得て特許を作成してから報告書等で明記することとした。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。